衛司特科技股份有限公司
WASTE Recovery Technology Inc.

2026 法人說明會

衛司特科技股份有限公司

TPEx 6894

免責聲明

- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
- 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、 完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正本簡報資料內容之責任。

簡報大綱

01 公司簡介

02 發展策略

03 營運概況與展望

04 Q&A

本簡報含前瞻性資訊，實際結果可能與規劃不同。歷史財務以正式財報為準。

01 公司簡介

本簡報含前瞻性資訊，實際結果可能與規劃不同。歷史財務以正式財報為準。

成立年份

2001 年

台灣台中市

集團員工人數

229 人

2026/09

主要服務項目

01 Recocell 電解回收系統

PCB、光電面板應用 BOO 業務模式 (Build-Operate-Own)

半導體、封裝應用 設備銷售與維護代操

02 不溶性氧化銥陽極鈦網

PCB 應用：HDI 盲孔填孔、mSAP、通孔脈衝電鍍

03 電池回收

子公司中央處理廠：城鋒科技與競零再生



林世民 博士

董事長暨總經理

子公司與服務據點

昆山

昆山衛司特環保設備有限公司

上海

上海衛司特環保設備有限公司

越南 河內

Waste Recovery Technology Vietnam Co., Ltd.

泰國 曼谷

Waste Recovery Technology (Thailand)



台灣據點

TAIWAN



台中

衛司特科技

母公司

台南

城鋒科技
(2026 new 鉛酸電池回收)

高雄

競零再生
(鋰電池回收)

衛司特科技 WASTE Recovery Technology Inc.

將含金屬廢液，回收為有價金屬

處理電子製造業線路形成過程產生的廢液，回收再生金屬資源



含銅廢液



RecoCell電解回收設備



再生銅

客戶價值　減少有害廢棄物清運與藥劑費用，增加有價金屬回收收益

依產業需求，提供兩種營運模式

案場數截至2026/09

PCB與光電

BOO投資營運

67 PCB案場　　**11** 光電案場

衛司特投資與營運
6年以上長約，合約期內依約分潤



半導體

設備銷售 + 代維護

20 半導體案場

衛司特銷售設備
另簽耗材與人力維護服務



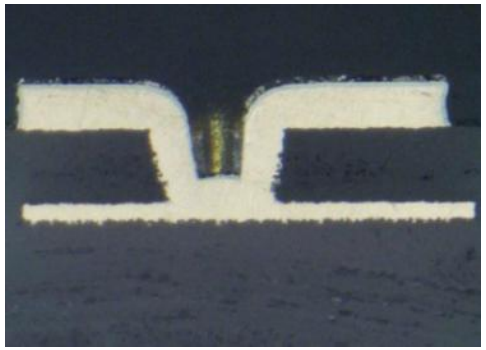
成長軌跡　長期駐點於客戶現場服務，運營案場隨產業擴展持續成長

不溶性氧化銥陽極鈦網

PCB製程HDI填孔與高深寬比通孔脈衝電鍍



PCB電鍍製程使用



HDI雷射微盲孔 - 直流電鍍

增層增加，重複雷射鑽孔與填孔
帶動鍍銅製程需求

應用:消費性電子、低軌衛星、ABF載板mSAP線路形成、CPO光通訊主板



高深寬比機械通孔 – 脈衝電鍍

高多層厚板擴產，跨層互連增加
帶動通孔鍍銅需求

板厚增、孔徑小，均勻電鍍更困難

應用：層數持續增加的AI伺服器板

鉛酸電池回收，轉製再生有價資源

子公司城鋒科技　鉛酸電池中央處理廠



回收鉛酸電池

城鋒科技

集中回收處理



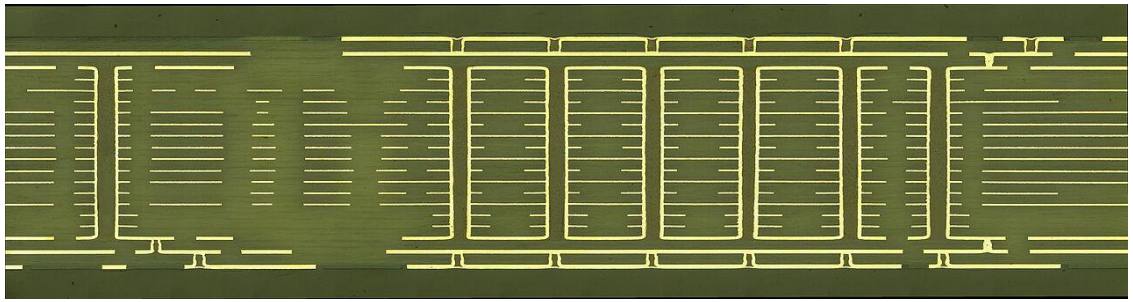
鉛錠等再生資源

02 發展策略

本簡報含前瞻性資訊，實際結果可能與規劃不同。歷史財務以正式財報為準。

衛司特科技 WASTE Recovery Technology Inc.

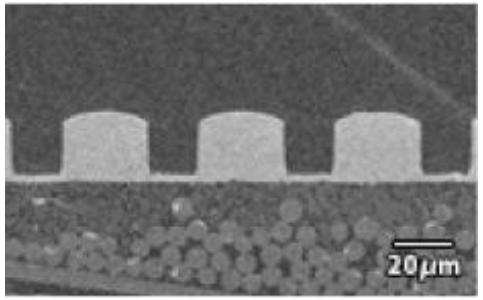
PCB層數與製程複雜度持續提升

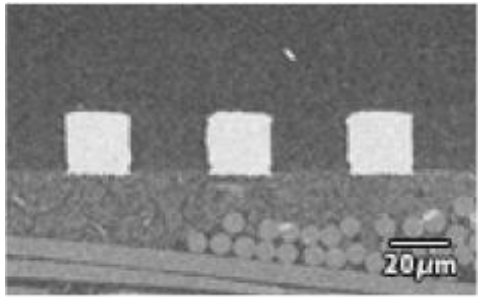


52 層 → **60 層** · · ⬆

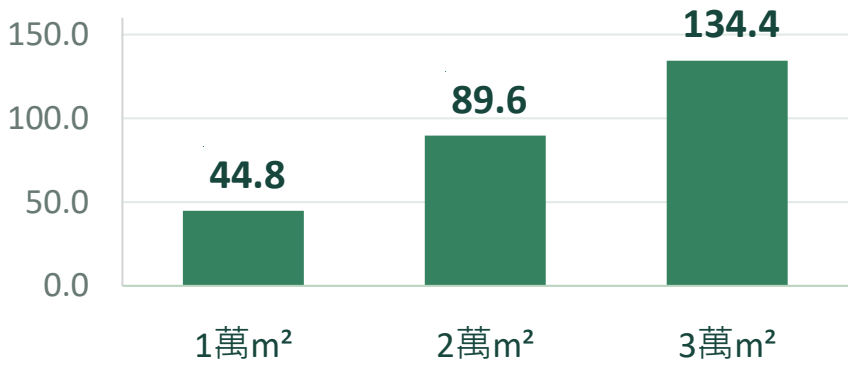
2026/04能力　　2027規劃

多層銅線路布局帶動大量銅蝕刻與電鍍需求





每萬平米PCB溶出銅量（kg）



1 m² × 1 μm

= 8.96 g 銅

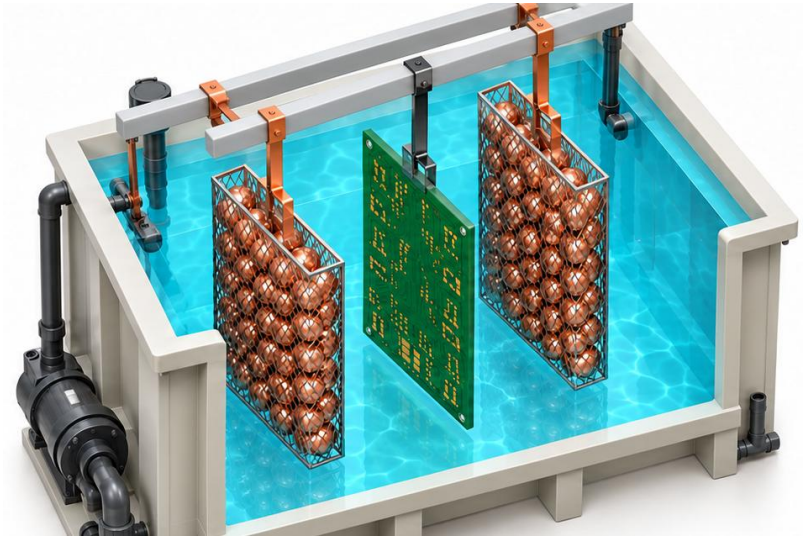
層數與增層道次
擴大實際處理面積

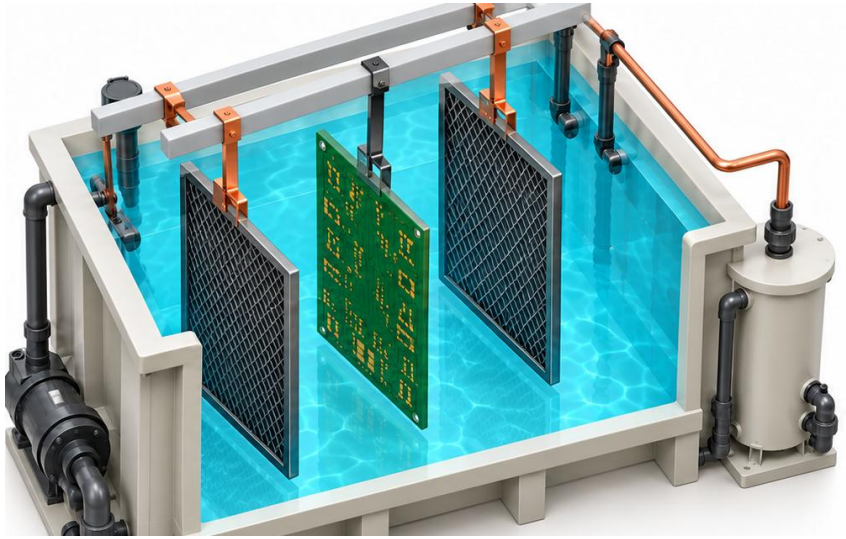
多層PCB帶動大量硫酸雙氧水蝕刻、粗化蝕刻、電鍍等需求，帶動大量含銅廢水處理需求

來源：MEC seed etching產品資料。照片為mSAP示例，前後圖形變化不等於處理量增幅。

不溶性氧化銥陽極於新世代PCB電鍍線大量使用

PCB板附加價值與前段製程投入提高，報廢與停機的代價更大，新線大幅減少傳統可溶性磷銅球陽極。





比較面向	可溶性磷銅球	氧化銥系不溶性陽極
產品品質	球體消耗，需管理電流分布，無法製作高階產品	幾何穩定，利於鍍銅一致性與藥水管理
維護保養	停機補球、清理陽極泥及濾袋	無須補球與銅陽極泥清理

新電鍍線出貨能見度至2030年，同時形成龐大累積性更換市場需求。

高品質面板導線鋁改銅，改變廢水處理配置

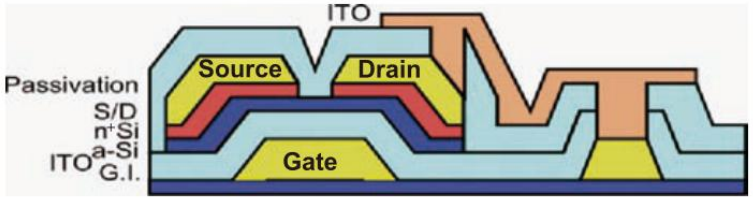
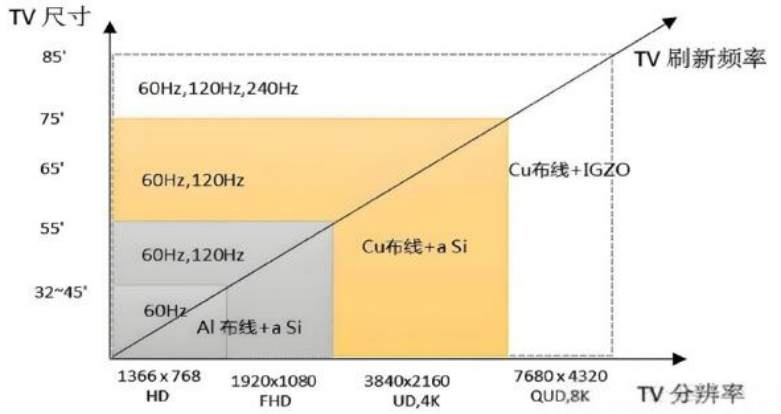


Figure 1 TFT Array Structure

Gate與Source/Drain金屬層改採低電阻Cu配線

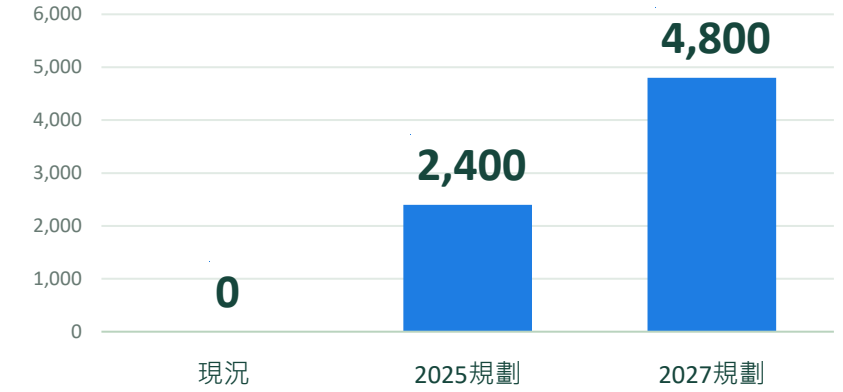


舊產線退出，高世代高品質產能占比提高，提升銅製程需求

TCL华星t1生产线铜制程升级改造项目环境影响报告表报批前全本公示

TCL华星t1生产线铜制程升级改造项目环境影响报告表已编制完成，现予以公示，公示稿见附件。
建设单位：TCL华星光电技术有限公司
项目名称：TCL华星t1生产线铜制程升级改造项目
建设项目地址：深圳市光明区凤凰街道塘明大道9-2号

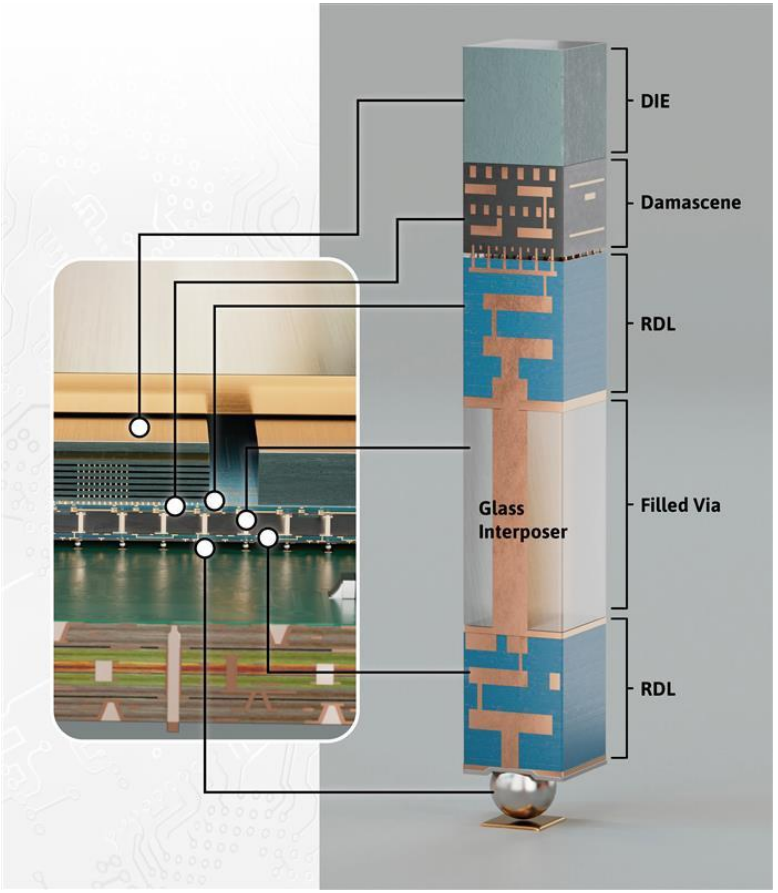
低濃度銅蝕刻廢水（m³ / 日）



TCL t1 環評 (2025年改造)：
銅蝕刻清洗廢水由0增至4,800 m³ / 日

	2025第一階段規劃	2027第二階段規劃
鋁改銅範圍	既有鋁製程的一半	其餘鋁製程全部
基板投片	8.25萬片 / 月	17.5萬片 / 月
母玻璃尺寸	2,200 × 2,500 mm	2,200 × 2,500 mm

發展策略 – 半導體與封裝擴產持續帶動金屬廢水處理需求



銅大馬士革電鍍

TSV或TGV銅穿孔電鍍

RDL銅重布線電鍍

錫球焊接

金屬	代表用途	已公開的製程例
銅	BEOL、TSV、RDL 銅柱與互連	硫酸銅電鍍、seed蝕刻、CMP
鎳	選用阻障層 UBM與凸塊	氨基磺酸鎳電鍍、其他配方依產品
鈷	接點互連 、部分襯層	PVD / CVD / ECD
錫	凸塊、微凸塊 焊帽與接合	MSA系SnAg電鍍、依金屬組合選配

隨半導體擴產持續帶動銅廢水處理需求，並隨製程複雜性帶動多元金屬廢水處理需求

來源：MacDermid 產品資料說明

城鋒科技新建 TSL (Top-Submerged-Lance) 頂吹浸沒式熔煉爐

傳統輻射式反射爐



燃料於浴面上方燃燒

TSL頂吹浸沒式熔池爐



燃料直接於熔渣浴內噴吹，氣泡強烈攪拌

台灣首次應用TSL頂吹爐於鉛酸電池回收

預計使回收出每噸鉛使用燃料（天然氣、液氧、煤炭）成本大幅下降，降低產鉛單位碳排

每噸鉛回收處理成本

預計下降 **60%**

城鋒新建精煉鉛系統，提升回收鉛成品附加價值

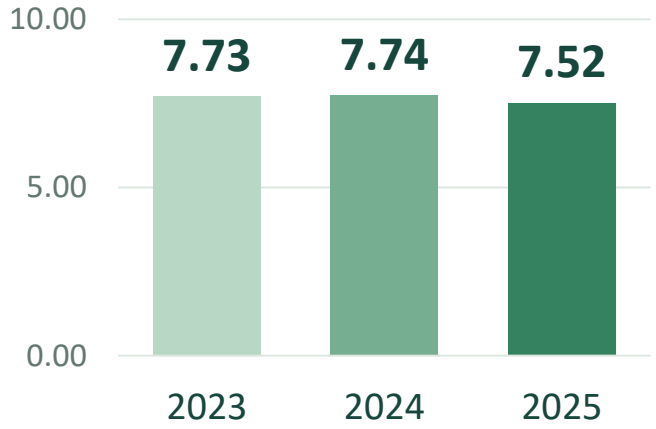


97% 粗鉛
基準鉛價 – 貼水3%



99.94% 精鉛
基準鉛價 + 升水7%

台灣廢鉛蓄電池回收量（萬噸）



台灣廢鉛蓄電池內每年約**4.5萬噸鉛**（60%含量）

以基準鉛價1900 USD/T計算，每年

潛在鉛價值 **8550萬美金**

03 營運概況與展望

本簡報含前瞻性資訊，實際結果可能與規劃不同。歷史財務以正式財報為準。

營收與獲利同步成長

營業收入

11.06 億元

年增 66.0%

歸屬母公司淨利

2.31 億元

年增 97.0%

每股盈餘 EPS

9.70 元

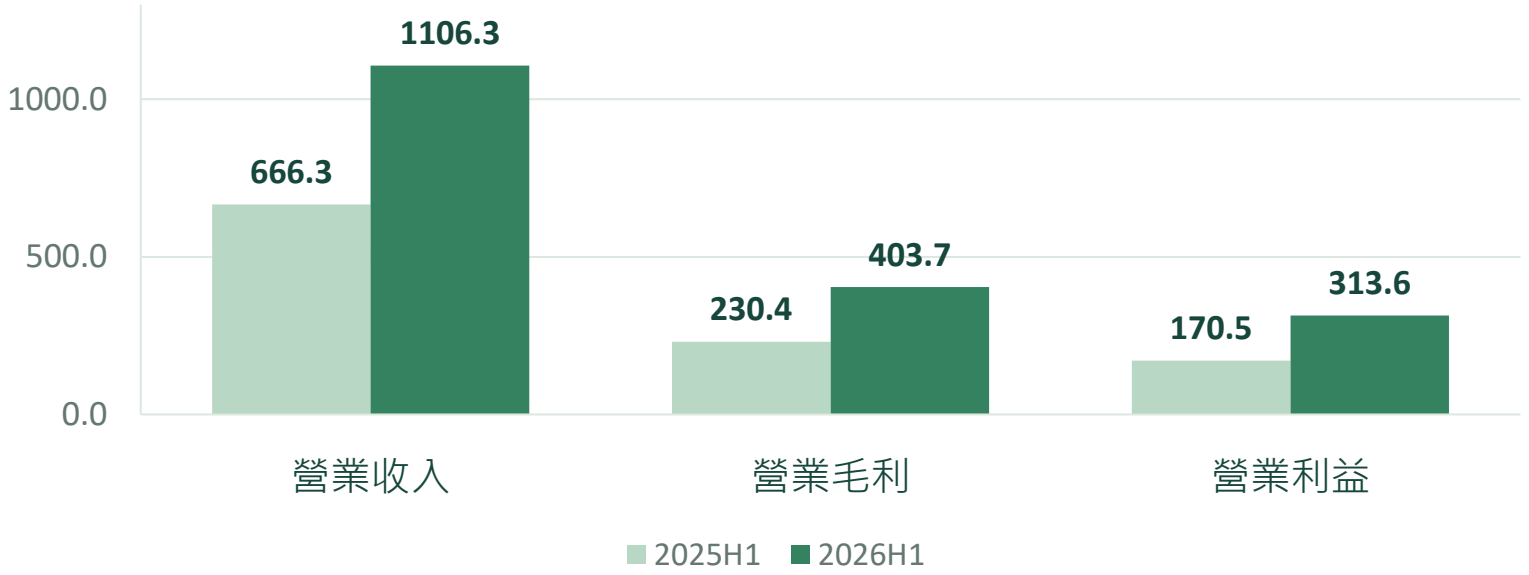
年增 97.2%

營業毛利率

36.5 %

增加 1.9 個百分點

主要損益比較 新台幣百萬元



營業利益年增

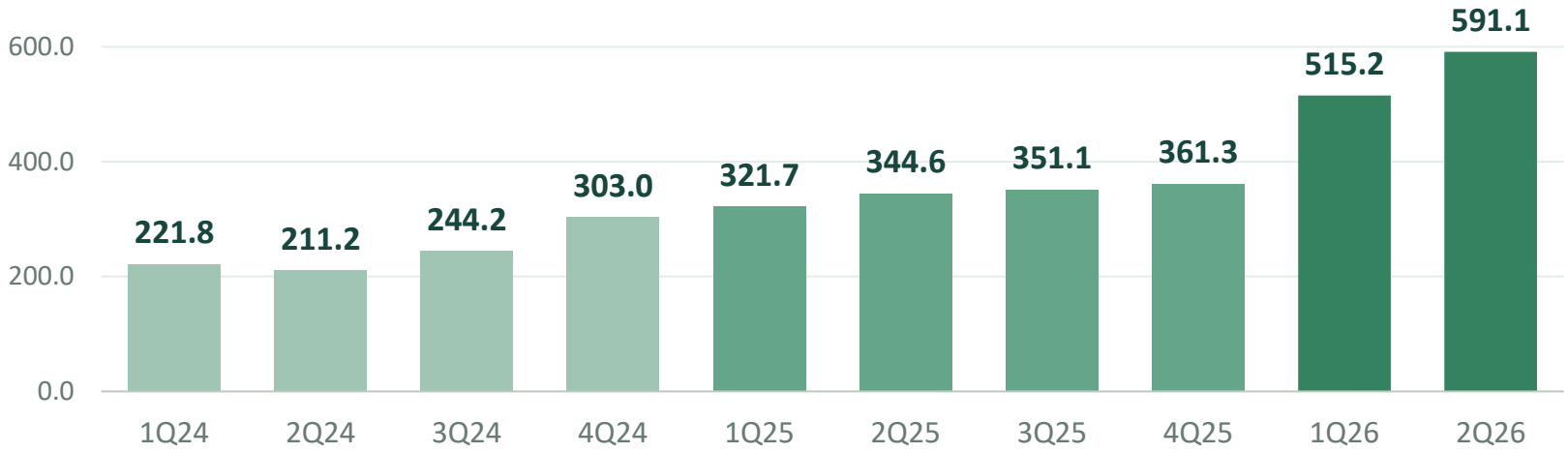
83.9%

ROE

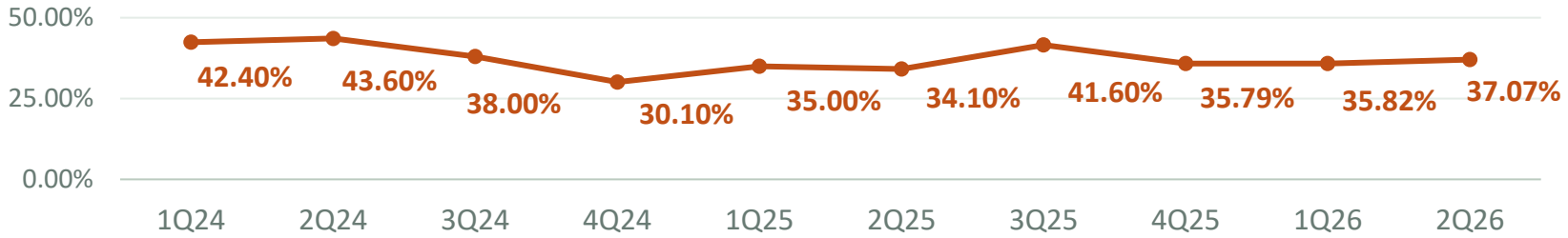
16.51% → 25.06%

季度營收連續8季成長

營收（新台幣百萬元）



毛利率



2026Q2 營收

5.91億元

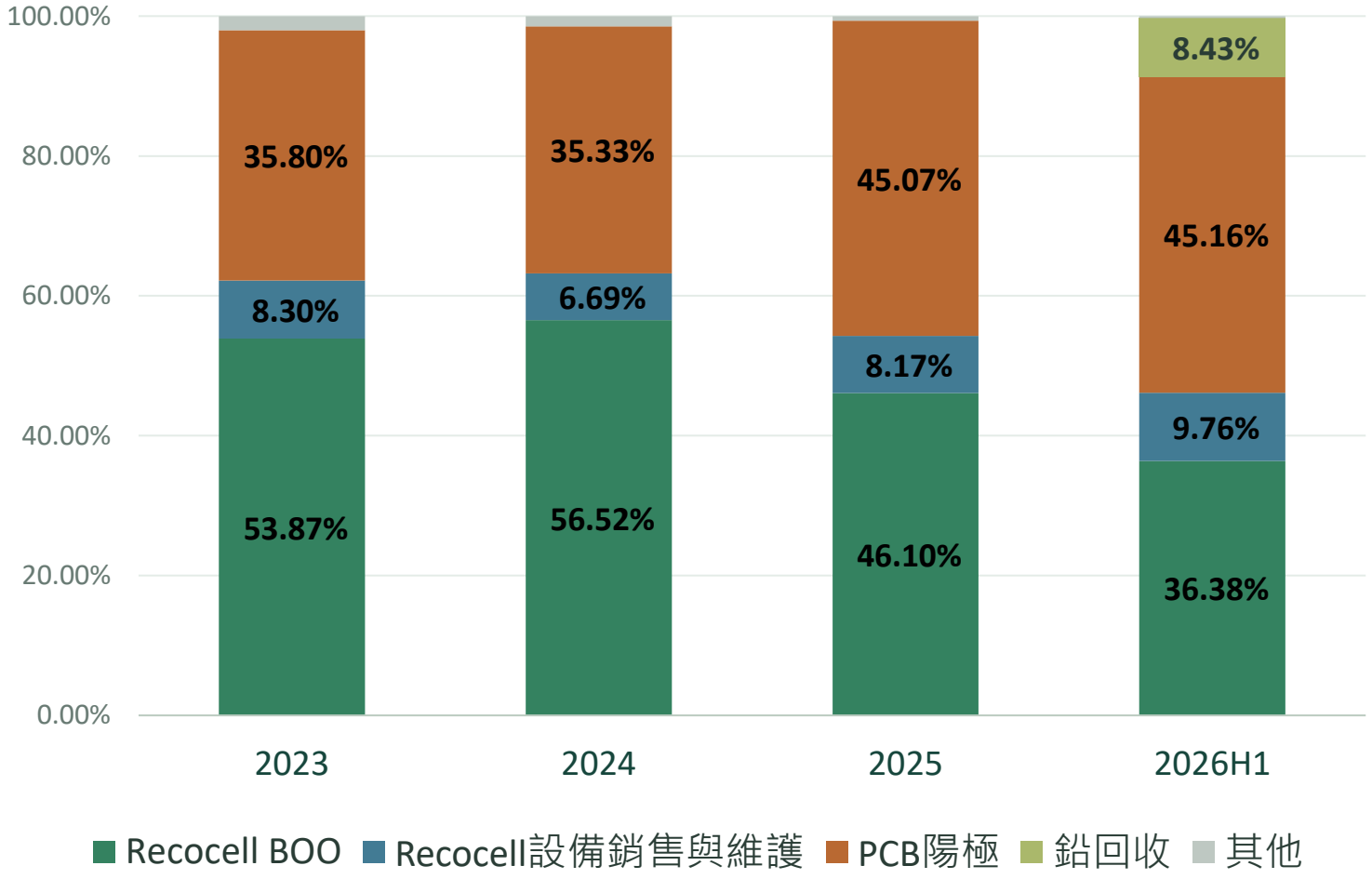
季增14.7% | 年增71.5%

2026Q2 毛利率

37.07%

較前季提升1.25個百分點

PCB陽極與半導體Recocell設備銷售與維護成長比例放大

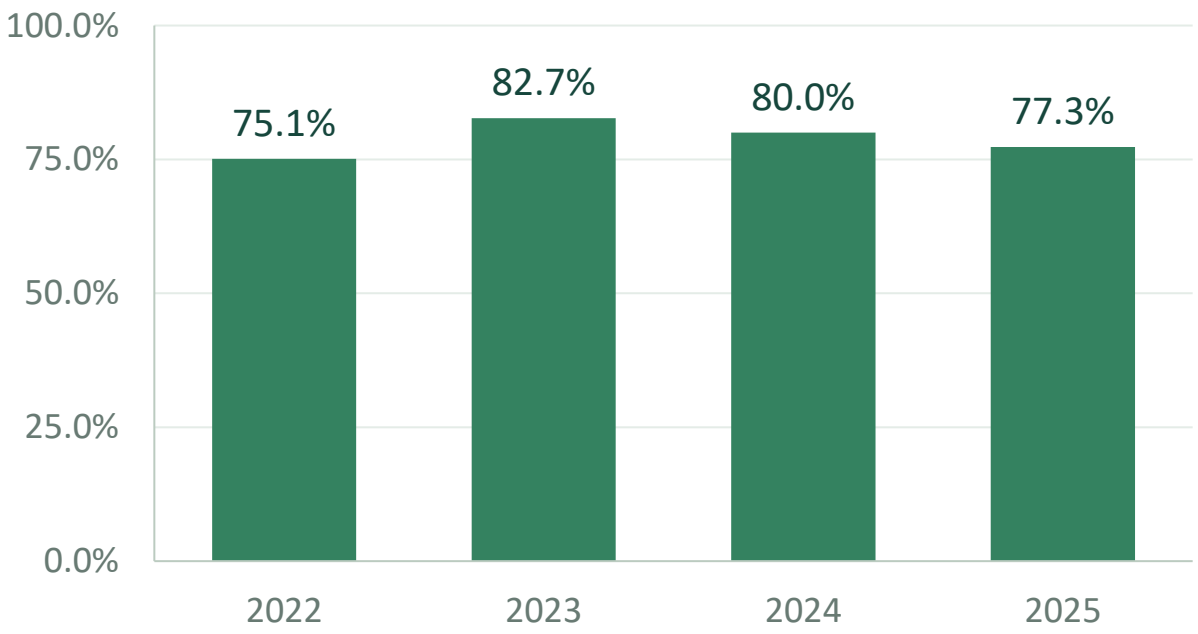


2026H1 半導體設備銷售與維護

1.07 億元

已經逼近2025全年1.12億元
2027成長動能更為顯著

歷年現金股利發放率



2.41億元

2026H1營業現金淨流入

25.06%

2026H1年化合併ROE

股利為盈餘年度，未來依決議。ROE含非控制權益、非全年預測。資料：公司與合併財報。

衛司特科技股份有限公司
WASTE Recovery Technology Inc.

Q&A

衛司特科技股份有限公司

TPEx 6894